

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ2659~2660-86

电子工业用树脂芯焊锡丝和软钎 焊用树脂系焊剂试验方法

1986-01-21发布

1986-10-01实施

中华人民共和国电子工业部 批准

目 录

SJ2659—86	电子工业用树脂芯焊锡丝	1
SJ2660—86	软钎焊用树脂系焊剂试验方法	6

软钎焊用树脂系焊剂试验方法

本标准主要对电子、电气设备和仪表等电路焊接所用的软钎焊树脂系焊剂（以下简称为焊剂）的试验方法规定。

1 试验项目及试料的取样方法

试料是根据试验项目并按表1取样。

表1 试验项目和试料的取样方法

试样 取样 方法 试验 项目	适用条款	树脂芯焊锡丝			焊锡膏			固体焊剂		液体焊剂		松香焊剂	
		原样 品	固体 部分	30%的 异丙醇 溶液	原样 品	固体 部分	液体 焊剂 部分	原样 品	30%的 异丙醇 溶液	原样 品	固体 部分	原样 品	30%的异 丙醇溶液
焊剂外观	3.1	0			0			0		0		0	
焊剂含量试验	3.2	0			0					0			
干燥度试验	3.3	0			0			0				0	
不粘着性试验	3.4									0			
色度试验	3.5									0			
粘度试验	3.6									0			
比重试验	3.7									0			
焊剂喷射试验	3.8	0			0			0		0			
扩展试验	3.9	0			0			0		0		0	
腐 蚀 试 验	铜镜或镀铜板腐蚀试验	3.10.1		0				0	0	0			0
	铜板腐蚀试验	3.10.2	0			0			0			0	
	细铜丝腐蚀试验	3.10.3			0				0	0			0
	施加电压腐蚀试验	3.10.4			0				0	0			0
	挂铜板腐蚀试验	3.10.5			0				0	0			0